

EasyPACK™ 2B IGBT モジュールおよび EasyBRIDGE 2200 V 整流器モジュール

EasyPACK™ 2B IGBTモジュールおよびEasyBRIDGE整流器モジュールは、既存Easy製品のラインアップを拡張したものです。EasyPACK™ 2Bは、IGBT4とEmitter-controlled 4ダイオードを搭載しています。本製品は、定格電流75 AのEasyパッケージで初の1700 Vモジュールです。2.2 kV整流ダイオードを搭載したEasyBRIDGE整流器モジュールは、Easy 1Bパッケージに収められています。どちらのモジュールも、熱伝導材料 (TIM) があらかじめ塗布されています。そのため、お客様は生産工程でサーマルグリスを扱う必要がなくなり、高い自動化レベルを実現できます。さらに、Easyパッケージにはベースプレートがなく、実績のあるPressFIT技術によってはんだレスで素早く組み立てられるため、1700 Vアプリケーションに最適です。



主な特長

- > EasyPACK™ 2Bパッケージ
 - > IGBT4 チップ世代
 - > Emitter-controlled 4ダイオード
 - > 1700 V、75 A
- > EasyBRIDGE
 - > 整流ダイオード
 - > 2200 V
- > Both EasyPACK™および EasyBRIDGE共通
 - > TIM (熱伝導材料) 塗布
 - > PressFITピン
 - > ベースプレートなし

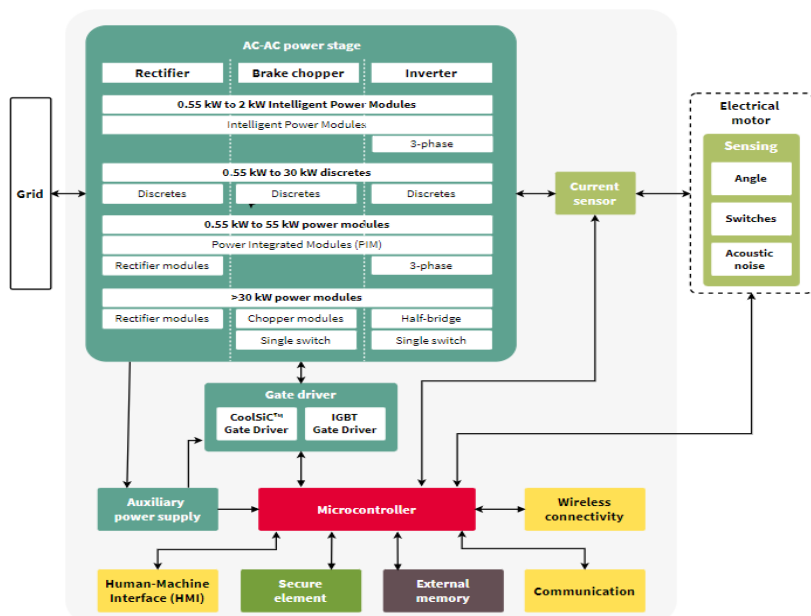
主な利点

- > 製造ラインでサーマルグリスを取り扱う必要がないため、製造のプロセスコストの低減可能
- > 高い自動化レベルと生産効率
- > 既存ラインアップを高圧クラスへ拡大
- > コスト削減

対象アプリケーション

- > サーボ駆動
- > 産業用ロボット

ブロック図



製品関連情報/オンライン サポート

[製品ページ FS75R17W2E4P_B11](#)

[製品ページ DDB6U50N22W1RP_B11](#)

[製品ページ Easy IGBTモジュールページ](#)

[製品ページ 整流ダイオードブリッジ&ACスイッチ](#)

製品概要およびユーザーマニュアルへのリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
FS75R17W2E4PB11BPSA1	SP005629666	AG-EASY2B-411
DDB6U50N22W1RPB11BPSA1	SP005632048	AG-EASY1B-411

【EasyPACK™ 2B IGBT モジュールおよび およびEasyBRIDGE 2200 V 整流器モジュール】

FAQ

➤ **Why Easy for 1700 V application?**

Easy modules as a baseplate-less solution help to reduce the system-cost in 1700 V applications

➤ **Can we realize different topologies with Easy Modules using the same chip technology?**

Easy modules with its easy customization approach provide the customer all the flexibility to realize different topologies. That doesn't pertain only to the existing chip technology (IGBT4 & emitter-controlled diode 4), but other chip technologies (e.g. TRENCHSTOP™ IGBT7) as well

➤ **What is the lead time to develop a new topology using the customization approach?**

6-7 months depending on the complexity of the topology